

# 矽光子異質整合與先進封裝技術論壇

~啟動下一代光電半導體融合新紀元~

- 會議時間：2024 年 06 月 20 日(四) 13:30 - 16:30
- 會議地點：國立臺灣科技大學視聽館 AU-101 貝殼廳 (臺北市大安區基隆路 4 段 43 號)
- 主辦單位：國際矽光子異質整合聯盟(HiSPA)
- 協辦單位：國立臺灣科技大學異質整合矽光電晶片研發中心(HiSiPIC)、財團法人光電科技工業協進會(PIDA)、日商駿河精機台灣分公司(SURUGA SEIKI)
- 議程表：

| 時間            | 主題  | 主講人                                    |
|---------------|---|--|
| 13:00 ~ 13:30 | 報到  |  |
| 13:30 ~ 13:40 | 開場致詞  | 國際矽光子異質整合聯盟<br>李三良 會長                  |
|               |   | 財團法人光電科技工業協進會<br>程道琳 執行長               |
| 13:40 ~ 13:45 | 大合照   |  |
| 13:45 ~ 14:05 |   | 元澄半導體(邀請中)                             |
| 14:05 ~ 14:25 | TBD   | 合聖科技股份有限公司<br>伍茂仁 博士                   |
| 14:25 ~ 14:45 | TBD   | 日月光半導體製造股份有限公司<br>工程發展中心<br>陳光雄 資深副總經理 |
| 14:45 ~ 15:05 | 休息與交流   |  |
| 15:05 ~ 15:25 | TBD   | 優貝克科技股份有限公司(ULVAC)<br>吳東嶸 執行副總經理       |
| 15:25 ~ 15:45 | Enabling Smart Factory for Photonics CP Automation      | 愛德萬測試股份有限公司<br>蘇清木 副總經理<br>蔡世傑 協理      |
| 15:45 ~ 16:05 | Silicon Photonics testing for Heterogeneous Integration | VLC Photonics<br>Iñigo Artundo CEO     |
| 16:05 ~ 16:30 | Wrap-up and closing remarks                             |  |
| 16:30 ~       | 賦歸  |  |